

# 2025-2031年中国半导体材料行业市场现状调查及 投资前景研判报告

报告大纲

## 一、报告简介

智研咨询发布的《2025-2031年中国半导体材料行业市场现状调查及投资前景研判报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://www.chyxx.com/research/1171445.html>

报告价格：电子版: 9800元 纸介版：9800元 电子和纸介版: 10000元

订购电话: 010-60343812、010-60343813、400-600-8596、400-700-9383

电子邮箱: sales@chyxx.com

联系人: 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

## 二、报告目录及图表目录

智研咨询专家团队倾力打造的《2025-2031年中国半导体材料行业市场现状调查及投资前景研判报告》（以下简称《报告》）正式揭晓，自2018年出版以来，已连续畅销7年，成功成为企业了解和开拓市场，制定战略方向的得力参考资料。报告从国家经济与产业发展的宏观战略视角出发，深入剖析了半导体材料行业未来的市场动向，精准挖掘了行业的发展潜力，并对半导体材料行业的未来前景进行研判。

本报告共七章，包含中国半导体材料行业细分市场分析，中国半导体材料行业领先企业生产经营分析，中国半导体材料行业市场及投资策略建议等内容。

报告中所有数据，均来自官方机构、行业协会等公开资料以及深入调研获取所得，并且数据经过详细核实和多方求证，以期为行业提供精准、可靠和有效价值信息！

半导体材料是制作半导体器件和集成电路的电子材料，是半导体工业的基础。根据工艺过程，半导体材料可分为晶圆制造材料和封装材料，其中晶圆制造材料又包括硅片、电子特气、CMP抛光液&抛光垫、光掩膜、光刻胶、湿电子化学品、靶材等；封装材料又包括封装基板、引线框架、键合丝、陶瓷封装材料等等。

受益于中国大陆晶圆制造及封测产能提升，国内半导体材料销售额在过去几年快速扩张。SEMI数据显示，2023年中国台湾以192亿美元的销售额，连续第14年成为全球最大的半导体材料消费地区，主要是因为晶圆代工大厂台积电需为包括苹果、AMD、英特尔和英伟达等在内的科技公司生产最先进的芯片；中国大陆半导体材料销售额为130.85亿美元，同比增长0.9%。

半导体材料处于整个半导体产业链的上游环节，对半导体产业发展起着重要支撑作用。半导体材料产业链上游为原材料，主要包括金属、电子陶瓷材料、半导体用碳化硅、砷化镓等，中游是指半导体材料，下游为半导体材料的主要应用领域，包括集成电路、半导体分立器件、光电子器件和传感器等。

从我国半导体材料行业区域分布来看，半导体材料行业产业链企业在全国绝大多数省份均有分布。其中江苏省半导体材料企业数量分布最多，同时上海、北京、广东等省份企业数量也相对集中。

作为一个见证了中国半导体材料十余年发展的专业机构，智研咨询希望能够与所有致力于与半导体材料行业企业携手共进，提供更多有效信息、专业咨询与个性化定制的行业解决方案，为行业的发展尽绵薄之力。

报告目录：

## 第1章 半导体材料行业概念界定及发展环境剖析

### 1.1 半导体材料的概念界定及统计口径说明

#### 1.1.1 半导体材料概念界定

#### 1.1.2 半导体材料的分类

(1) 前端制造材料

(2) 后端封装材料

#### 1.1.3 行业所属的国民经济分类

#### 1.1.4 本报告的数据来源及统计标准说明

### 1.2 半导体材料行业政策环境分析

#### 1.2.1 行业监管体系及机构

#### 1.2.2 行业规范标准

#### 1.2.3 行业发展相关政策汇总及重点政策解读

(1) 行业发展相关政策汇总

(2) 行业发展重点政策解读

#### 1.2.4 行业相关规划汇总及解读

(1) 国家层面

(2) 地方层面

#### 1.2.5 政策环境对行业发展的影响分析

### 1.3 半导体材料行业经济环境分析

#### 1.3.1 宏观经济现状

(1) GDP发展分析

(2) 固定资产投资分析

(3) 工业经济运行分析

#### 1.3.2 经济转型升级发展分析（智能制造）

#### 1.3.3 宏观经济展望

(1) GDP增速预测

(2) 行业综合展望

#### 1.3.4 经济环境对行业发展的影响分析

### 1.4 半导体材料行业投资环境分析

#### 1.4.1 国家集成电路产业投资基金

(1) 大基金一期

(2) 大基金二期

#### 1.4.2 半导体材料行业投资、兼并与重组分析

(1) 行业投资、兼并与重组发展现状分析

## (2) 行业投资、兼并与重组发展事件汇总

### 1.4.3 投资环境对行业发展的影响分析

### 1.5 半导体材料行业技术环境分析

#### 1.5.1 半导体行业技术迭代

#### 1.5.2 相关专利的申请情况分析

##### (1) 硅片

##### (2) 电子特气

##### (3) 光刻胶

#### 1.5.3 美国对中国半导体行业的相关制裁事件

#### 1.5.4 半导体材料行业技术发展趋势

#### 1.5.5 技术环境对行业发展的影响分析

## 第2章 全球及中国半导体行业发展及半导体材料所处位置

### 2.1 半导体产业迁移历程分析

#### 2.1.1 全球半导体产业迁移路径总览

#### 2.1.2 阶段一：从美国向日本迁移

#### 2.1.3 阶段二：向韩国、中国台湾迁移

#### 2.1.4 阶段三：向中国大陆地区转移

#### 2.1.5 全球半导体产业发展总结分析

### 2.2 全球半导体行业发展现状分析

#### 2.2.1 全球半导体行业市场规模

#### 2.2.2 全球半导体行业结构竞争格局

#### 2.2.3 全球半导体行业产品竞争格局

#### 2.2.4 全球半导体行业区域竞争格局

### 2.3 中国半导体行业发展现状分析

#### 2.3.1 中国半导体行业市场规模

#### 2.3.2 中国半导体行业结构竞争格局

##### (1) 中国半导体行业结构竞争格局

##### (2) 半导体设计环节规模

##### (3) 半导体制造环节规模

##### (4) 半导体封装测试环节规模

#### 2.3.3 中国半导体行业区域竞争格局

### 2.4 半导体材料与半导体行业的关联

#### 2.4.1 半导体材料在半导体产业链中的位置

#### 2.4.2 半导体材料对半导体行业发展的影响分析

## 2.5 全球及中国半导体行业发展前景及趋势分析

### 2.5.1 半导体行业发展前景分析

(1) 全球半导体行业发展前景分析

(2) 中国半导体行业发展前景分析

### 2.5.2 半导体行业发展趋势分析

## 第3章 全球半导体材料行业发展现状及前景分析

### 3.1 全球半导体材料行业发展现状分析

#### 3.1.1 全球半导体材料行业发展历程

#### 3.1.2 全球半导体材料行业市场规模

#### 3.1.3 全球半导体材料行业竞争格局

(1) 区域竞争格局

(2) 产品竞争格局

(3) 企业/品牌竞争格局

### 3.2 全球主要国家/地区半导体材料行业发展现状分析

#### 3.2.1 中国台湾地区半导体材料行业发展分析

(1) 半导体材料行业发展特点

(2) 半导体材料行业市场规模

(3) 半导体材料行业在全球的地位

#### 3.2.2 韩国半导体材料行业发展分析

(1) 半导体材料行业发展特点

(2) 半导体材料行业市场规模

(3) 半导体材料行业在全球的地位

#### 3.2.3 日本半导体材料行业发展分析

(1) 半导体材料行业发展特点

(2) 半导体材料行业市场规模

(3) 半导体材料行业在全球的地位

#### 3.2.4 北美半导体材料行业发展分析

(1) 半导体材料行业发展特点

(2) 半导体材料行业市场规模

(3) 半导体材料行业在全球的地位

### 3.3 全球半导体材料代表企业案例分析

#### 3.3.1 日本揖斐电株式会社 (IBIDEN)

(1) 企业基本情况

(2) 企业经营情况

- (3) 企业半导体材料业务布局
- (4) 企业在华投资布局情况
- 3.3.2 日本信越化学工业株式会社
  - (1) 企业基本情况
  - (2) 企业经营情况
  - (3) 企业半导体材料业务布局
  - (4) 企业在华投资布局情况
- 3.3.3 日本株式会社SUMCO
  - (1) 企业基本情况
  - (2) 企业经营情况
  - (3) 企业半导体材料业务布局
  - (4) 企业在华投资布局情况
- 3.3.4 空气化工产品有限公司
  - (1) 企业基本情况
  - (2) 企业经营情况
  - (3) 企业半导体材料业务布局
  - (4) 企业在华投资布局情况
- 3.3.5 林德集团
  - (1) 企业基本情况
  - (2) 企业经营情况
  - (3) 企业半导体材料业务布局
  - (4) 企业在华投资布局情况
- 3.4 全球半导体材料行业发展前景及趋势
  - 3.4.1 全球半导体材料行业发展前景分析
  - 3.4.2 全球半导体材料行业发展趋势分析

## 第4章 中国半导体材料行业发展现状分析

- 4.1 中国半导体材料行业发展概述
  - 4.1.1 行业发展历程分析
  - 4.1.2 中国半导体材料行业市场规模分析
  - 4.1.3 中国半导体材料行业在全球的地位分析
  - 4.1.4 中国半导体材料行业企业竞争格局
- 4.2 中国半导体材料行业进出口分析
  - 4.2.1 中国半导体材料行业进出口市场分析
  - 4.2.2 中国半导体材料行业进口分析

- (1) 行业进口总体分析
- (2) 行业进口主要产品分析
- 4.2.3 中国半导体材料行业出口分析
  - (1) 行业出口总体分析
  - (2) 行业出口主要产品分析
- 4.3 中国半导体材料行业波特五力模型分析
  - 4.3.1 现有竞争者之间的竞争
  - 4.3.2 对关键要素的供应商议价能力分析
  - 4.3.3 对消费者议价能力分析
  - 4.3.4 行业潜在进入者分析
  - 4.3.5 替代品风险分析
  - 4.3.6 竞争情况总结
- 4.4 中国半导体材料行业发展痛点分析
  - 4.4.1 前端晶圆制造材料核心优势不足
  - 4.4.2 半导体材料对外依存度大
  - 4.4.3 半导体材料国产化不足

## 第5章 中国半导体材料行业细分市场分析

- 5.1 中国半导体材料工艺及细分市场构成分析
  - 5.1.1 半导体制造工艺
  - 5.1.2 中国半导体材料行业细分市场格局
    - (1) 中国半导体材料行业细分市场竞争格局
    - (2) 中国晶圆制造材料细分产品规模情况
    - (3) 中国封装材料细分产品规模情况
- 5.2 中国半导体材料（前端晶圆制造材料）发展现状及趋势分析
  - 5.2.1 中国半导体硅片发展现状及趋势分析
    - (1) 半导体硅片工艺概述
    - (2) 半导体硅片技术发展分析
    - (3) 半导体硅片发展现状分析
    - (4) 半导体硅片竞争格局
    - (5) 半导体硅片国产化现状
    - (6) 半导体硅片发展趋势分析
  - 5.2.2 中国电子特气发展现状及趋势分析
    - (1) 电子特气工艺概述
    - (2) 电子特气技术发展分析

- (3) 电子特气发展现状分析
- (4) 电子特气竞争格局
- (5) 电子特气国产化现状
- (6) 电子特气发展趋势分析
- 5.2.3 中国光掩膜版发展现状及趋势分析
  - (1) 光掩膜版工艺概述
  - (2) 光掩膜版技术发展分析
  - (3) 光掩膜版发展现状分析
  - (4) 光掩膜版竞争格局
  - (5) 光掩膜版国产化现状
  - (6) 光掩膜版发展趋势分析
- 5.2.4 中国光刻胶及配套材料发展现状及趋势分析
  - (1) 光刻胶及配套材料工艺概述
  - (2) 光刻胶及配套材料技术发展分析
  - (3) 光刻胶及配套材料发展现状分析
  - (4) 光刻胶及配套材料竞争格局
  - (5) 光刻胶及配套材料国产化现状
  - (6) 光刻胶及配套材料发展趋势分析
- 5.2.5 中国抛光材料发展现状及趋势分析
  - (1) 抛光材料工艺概述
  - (2) 抛光材料技术发展分析
  - (3) 抛光材料发展现状分析
  - (4) 抛光材料竞争格局
  - (5) 抛光材料国产化现状
  - (6) 抛光材料发展趋势分析
- 5.2.6 中国湿电子化学品发展现状及趋势分析
  - (1) 湿电子化学品工艺概述
  - (2) 湿电子化学品技术发展分析
  - (3) 湿电子化学品发展现状分析
  - (4) 湿电子化学品竞争格局
  - (5) 湿电子化学品国产化现状
  - (6) 湿电子化学品发展趋势分析
- 5.2.7 中国靶材发展现状及趋势分析
  - (1) 靶材工艺概述
  - (2) 靶材技术发展分析

- (3) 靶材发展现状分析
  - (4) 靶材竞争格局
  - (5) 靶材国产化现状
  - (6) 靶材发展趋势分析
- 5.3 中国半导体材料（后端封装材料）发展现状及趋势分析
- 5.3.1 中国封装基板发展现状及趋势分析
- (1) 封装基板工艺概述
  - (2) 封装基板技术发展分析
  - (3) 封装基板发展现状分析
  - (4) 封装基板竞争格局
  - (5) 封装基板国产化现状
  - (6) 封装基板发展趋势分析
- 5.3.2 中国引线框架发展现状及趋势分析
- (1) 引线框架工艺概述
  - (2) 引线框架技术发展分析
  - (3) 引线框架发展现状分析
  - (4) 引线框架竞争格局
  - (5) 引线框架国产化现状
  - (6) 引线框架发展趋势分析
- 5.3.3 中国键合线发展现状及趋势分析
- (1) 键合线工艺概述
  - (2) 键合线技术发展分析
  - (3) 键合线市场规模分析
  - (4) 键合线竞争格局
  - (5) 键合线国产化现状
  - (6) 键合线发展趋势分析
- 5.3.4 中国塑封料发展现状及趋势分析
- (1) 塑封料工艺概述
  - (2) 塑封料技术发展分析
  - (3) 塑封料市场规模分析
  - (4) 塑封料竞争格局
  - (5) 塑封料国产化现状
  - (6) 塑封料发展趋势分析
- 5.3.5 中国陶瓷封装材料发展现状及趋势分析
- (1) 陶瓷封装材料工艺概述

- (2) 陶瓷封装材料技术发展分析
- (3) 陶瓷封装材料市场规模分析
- (4) 陶瓷封装材料竞争格局
- (5) 陶瓷封装材料国产化现状
- (6) 陶瓷封装材料发展趋势分析

## 第6章 中国半导体材料行业领先企业生产经营分析

### 6.1 半导体材料行业代表企业概况

### 6.2 半导体材料行业代表性企业案例分析

#### 6.2.1 TCL中环新能源科技股份有限公司

- (1) 企业概况
- (2) 企业经营状况
- (3) 企业盈利能力
- (4) 企业市场战略

#### 6.2.2 上海硅产业集团股份有限公司

- (1) 企业概况
- (2) 企业经营状况
- (3) 企业盈利能力
- (4) 企业市场战略

#### 6.2.3 浙江金瑞泓科技股份有限公司

- (1) 企业概况
- (2) 企业经营状况
- (3) 企业盈利能力
- (4) 企业市场战略

#### 6.2.4 有研新材料股份有限公司

- (1) 企业概况
- (2) 企业经营状况
- (3) 企业盈利能力
- (4) 企业市场战略

#### 6.2.5 福建阿石创新材料股份有限公司

- (1) 企业概况
- (2) 企业经营状况
- (3) 企业盈利能力
- (4) 企业市场战略

#### 6.2.6 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

- (1) 企业概况
- (2) 企业经营状况
- (3) 企业盈利能力
- (4) 企业市场战略

#### 6.2.7 湖北鼎龙控股股份有限公司

- (1) 企业概况
- (2) 企业经营状况
- (3) 企业盈利能力
- (4) 企业市场战略

#### 6.2.8 安集微电子科技(上海)股份有限公司

- (1) 企业概况
- (2) 企业经营状况
- (3) 企业盈利能力
- (4) 企业市场战略

#### 6.2.9 江苏雅克科技股份有限公司

- (1) 企业概况
- (2) 企业经营状况
- (3) 企业盈利能力
- (4) 企业市场战略

#### 6.2.10 苏州金宏气体股份有限公司

- (1) 企业概况
- (2) 企业经营状况
- (3) 企业盈利能力
- (4) 企业市场战略

### 第7章 中国半导体材料行业市场及投资策略建议

#### 7.1 中国半导体材料行业市场

##### 7.1.1 半导体材料行业生命周期判断

##### 7.1.2 半导体材料行业发展潜力评估

##### 7.1.3 半导体材料行业前景预测

#### 7.2 中国半导体材料行业投资特性

##### 7.2.1 行业进入壁垒分析

##### 7.2.2 行业退出壁垒分析

##### 7.2.3 行业投资风险预警

#### 7.3 中国半导体材料行业投资价值与投资机会

### 7.3.1 行业投资价值评估

### 7.3.2 行业投资机会分析

## 7.4 中国半导体材料行业投资策略与可持续发展建议

### 7.4.1 行业投资策略与建议

### 7.4.2 行业可持续发展建议

#### 图表目录：

图表1：半导体前端制造材料分类及主要用途

图表2：半导体后端封装材料分类及主要用途

图表3：半导体材料行业所属的国民经济分类

图表4：报告的研究方法及数据来源说明

图表5：中国半导体材料行业监管体制

图表6：截止到2024年中国半导体材料标准

图表7：截至2024年半导体材料行业发展主要政策汇总

图表8：《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》政策解读

图表9：《国家集成电路产业发展推进纲要》政策解读与规划

图表10：中国主要省市半导体产业发展规划

图表11：“十四五”期间地方层面半导体产业规划

图表12：2020-2024年中国GDP增长走势图（单位：万亿元，%）

图表13：2020-2024年全国固定资产投资（不含农户）增长速度（单位：万亿元，%）

图表14：2020-2024年中国同比工业增加值增速（单位：%）

图表15：2024年中国GDP的各机构预测（单位：%）

图表16：2024年中国综合展望

图表17：中国大基金一期半导体材料投资标的（单位：亿元，%）

图表18：中国大基金二期半导体材料投资标的（单位：亿元，亿美元，%）

图表19：2020-2024年中国半导体行业并购交易案汇总（单位：百万美元，亿人民币）

图表20：2020-2024年中国半导体材料行业投融资事件情况分析（单位：件，亿元）

更多图表见正文.....

详细请访问：<https://www.chyxx.com/research/1171445.html>